**证券代码：605358**  **证券简称：立昂微**

**杭州立昂微电子股份有限公司**

**投资者关系活动记录表（2024年第三季度业绩说明会）**

编号：2024-005

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □新闻发布会  □现场参观 □电话会议  ●业绩说明会 □其他 |
| 参与单位名称 | 参加公司2024年第三季度业绩说明会的投资者 |
| 时间 | 2024年11月5日 11：00-12:00 |
| 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长：王敏文  董事会秘书、财务总监：吴能云  独立董事：吴仲时  副总经理、立昂东芯总经理：汪耀祖 |
| 投资者关系活动记录 | 公司已于2024年10月29日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司于2024年11月05日11:00-12:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行了回答。  主要问题及答复如下（部分提问因展示需要调整了表述）：  1. 报告期内，立昂东芯主要在研发哪些技术，有何进展？立昂东芯的毛利率有多少？  答：立昂东芯目前在研发碳化硅基氮化镓芯片以及拓展现有品类的新产品。2024年以来立昂东芯的毛利率已经转正，随着未来出货量的上升，毛利率有望逐季提升。  2.请更新下公司目前各个业务的产能？  答：公司6英寸抛光片（含衬底片）产能60万片/月、8英寸抛光片（含衬底片）产能27万片/月（预计2024年12月达到57万片/月，较前期预测推后系设备调试等正常原因所致）、6-8英寸（兼容）外延片产能70万片/月（预计2025年3月底前达到90万片/月，较前期预测推后系设备交期延长等正常原因所致）；衢州基地12英寸抛光片（含衬底片）产能15万片/月、12英寸外延片产能10万片/月；嘉兴基地12英寸抛光片产能8万片/月，预计2024年年底有望达到15万片/月。  3. 公司三季度硅片及射频的销量环比增幅不错的情况下，是什么原因导致营业收低于产品销量的增速？虽然三季度的销售额创了历史新高，但对比二季度的销售价格，公司有部分产品的销价是不及二季度的，请问是哪个业务板块的产品销售价格还没有止跌？  答：公司硅片产品、射频芯片产品中不同类别产品的价值量差异较大，不同季度出货产品结构的变化导致营收的波动属于正常波动范围。公司三季度与光伏有关的功率半导体芯片的产品销售价格较二季度有所下滑。  4. 是什么原因导致立昂东芯的产能利用率连续几个季度都维持在40%附近波动？  答：产能利用率的提升有一个生产磨合的过程，且前期部分设备的维修调试限制了产能的释放。目前立昂东芯杭州基地的产能为月产7500片，立昂东芯2024年10月的产能利用率已接近60%，年底有望达到三分之二以上。  5. 与同行对比，立昂东芯有何优势与他们同台竞技？  答：随着多年的研发积累，立昂东芯目前的技术水平处于海内外同行的同一梯队，部分技术处于行业领先地位，如：成为行业内首家量产二维可寻址激光雷达VCSEL芯片的制造厂商、pHEMT工艺技术射频芯片产品已应用于国产低轨卫星并实现规模出货等。  6. 网络上流传华为海思的射频芯片部分产能是立昂东芯代工的，是否属实？公司是否通唯捷创芯间接供货华为的射频芯片？  答：公司通过昂瑞微、唯捷创芯等多家设计公司供应国内外的多家头部手机终端客户。  7. 公司的射频芯片可用于低轨卫星，主要是卫星端还是手机端？低轨卫星的出货量大概有多少？  答：公司的低轨卫星射频芯片产品应用于卫星端。低轨卫星的出货量正处于爬坡阶段。  8. 立昂东芯的砷化镓的衬底来源于外采，会不会影响公司产品的稳定性？公司目前射频业务的产能如果满销满产的话能支撑多少规模的收入体量？  答：目前国内多家砷化镓衬底厂家的产品已通过立昂东芯的认证，能够保证公司产品供应链的稳定性。按照年产能15万片6英寸射频芯片的产能计算，如果满产约为10亿元的收入体量。  9. 立昂东芯正在研发氮化镓，基于GaN的射频产品何时能够出货？  答：立昂东芯目前正在开发6英寸碳化硅基氮化镓射频芯片，预计2025年上半年推出产品。  10. 半年报射频芯片销售收入才1.3亿，公司回答满产可达10亿，是不是新的利润增长点？  答：预计射频业务板块在未来几年将成为公司新的重要的利润增长点。  11. 立昂东芯是否有滤波器baw、saw等的技术储备？  答：立昂东芯目前暂时没有滤波器baw、saw等产品的开发计划。  12. 立昂东芯海宁基地预计可于 2024年第四季度投入运营，目前已经是第四季度了，海宁东芯几月份可以投入运营？  答：海宁立昂东芯生产基地预计可于2024年12月底投入运营。  13. 横向器件的pHemt一般需要多少层光刻？立昂东芯phemt的工艺节点进展到多少微米了?  答：横向器件的pHemt一般需要15-20层光刻，目前工艺节点为0.15微米。  14.公司近年半导体射频芯片发展迅速，请问该业务产能、产能利用率及满产产值（按现价）分别是多少，未来有何布局？另外，VCSEL芯片是否属光芯片，能否用于光通信模块？  答：射频芯片杭州基地目前产能9万片/年，海宁基地在2024年底将建成6万片/年的产能。杭州基地目前产能利用率接近60%，年底有望达到三分之二。年产15万片的产能满产产值约为10亿元。VCSEL芯片可用于光通讯，公司生产的VCSEL芯片应用于光通信的主要客户有老鹰半导体、西安光机所、西安芯湾、江西德瑞等。  15. 公司12英寸硅片出货量快速上升，出货的12英寸硅片中，抛光片和外延片的占比大约是多少？12英寸硅片目前毛利率为多少？预计何时能够扭亏为盈？  答：公司12英寸硅片目前的出货产品中，抛光片约占三分之二，外延片约占三分之一。2024年前三季度12英寸硅片仍为负毛利率，预计出货量（正片）达到产能的三分之二以上将实现扭亏为盈。  16. 四季度硅片需求是否依然持续走高？  答：公司预计第四季度硅片订单环比第三季度将进一步提升，其中6-8英寸硅片接近满产；12英寸硅片的产能利用率不断提升，出货量逐月创出历史新高。  17. 四季度硅片价格有所回升么？  答：预计第四季度硅片价格环比第三季度基本持平。  18.请问当前公司12寸大硅片和8寸硅片的产能利用率分别是多少？对四季度有何展望？  答：公司12英寸硅片（抛光+衬底）目前产能利用率接近60%，8英寸硅片接近满产。半导体行业自2024年第二季度开始见底回升，订单逐季好转，公司三个业务板块第四季度订单环比将进一步提升。  19. 除了良好经营外，有无其他提振股价措施考虑？  答：公司股价波动受多种因素影响，敬请投资者注意投资风险。公司将持续做好生产经营，以优良业绩回报广大投资者。此外，公司2024年内已实施两次股份回购，累计回购金额1.7亿元。同时公司将严格按照信息披露规则做好信息披露管理。  20. 在现有大环境下，公司有无并购考虑？  答：如有相关事项公司将严格按照信息披露规则履行信息披露义务。 |
| 其他事项 | 1.本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。  2. 关于公司2024年第三季度业绩说明会的详细情况，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看。因为时间关系，未能在公司2024年第三季度业绩说明会交流的问题，后续欢迎大家继续通过电话、邮件、上交所e互动平台等方式与公司进行交流。 |
| 资料清单（如有） | 无 |